



|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Title of Change:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Update Notice – Cancellation of IPCN22316Z - Transfer of wafer fabrication operations for ON Semiconductor Zener products to ON Niigata, Japan. Change to AlSiCu top metal, Cu wire and Henkel mold compound.  |                                        |
| <b>Proposed Changed Material First Ship Date:</b>                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Current Material Last Order Date:</b>                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Current Material Last Delivery Date:</b>                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Product Category:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Active components – Discrete components                                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Contact information:</b>                                                                                                                                                                                                                                | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Hiroshi.Koizumi@onsemi.com>                                                                                                                               |                                        |
| <b>Samples:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or <PCN.samples@onsemi.com><br>Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. |                                        |
| <b>Additional Reliability Data:</b>                                                                                                                                                                                                                        | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Nicky.Siu@onsemi.com>.                                                                                                                                    |                                        |
| <b>Type of Notification:</b>                                                                                                                                                                                                                               | ON Semiconductor will consider this cancellation of change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>.               |                                        |
| <b>Change Category</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Type of Change</b>                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Process – Wafer Production                                                                                                                                                                                                                                 | New / change of metallization (specifically chip frontside)"<br>Move of all or part of wafer fab to a different location/site/subcontractor (qualification of an additional manufacturing site)                |                                        |
| Process – Assembly                                                                                                                                                                                                                                         | Change of wire bonding<br>Change of mold compound                                                                                                                                                              |                                        |
| <b>Description and Purpose:</b><br><br>Update Notice for the Cancellation of IPCN22316Z - Transfer of wafer fabrication operations for ON Semiconductor Zener products to ON Niigata, Japan. Change to AlSiCu top metal, Cu wire and Henkel mold compound. |                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Reason / Motivation for Change:</b>                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability:</b>                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Sites Affected:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | ON Semiconductor Sites:<br>ON ISMF, Malaysia<br>ON Leshan, China<br>ON Niigata, Japan                                                                                                                          | External Foundry/Subcon Sites:<br>None |
| <b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Reliability Data Summary:</b> N/A                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Electrical Characteristic Summary:</b> N/A                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                        |

**List of Affected Parts:**

|                |                |                 |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| SMMSZ4698T1G   | SZBZX84C24ET1G | SZBZX84C62ET1G  | SZMMSZ4698T1G  |
| SMMSZ4701T1G   | SZBZX84C27LT1G | SZBZX84C75ET1G  | SZMMSZ4701ET1G |
| SMMSZ4704T1G   | SZBZX84C27LT3G | SZMMBZ5241BLT1G | SZMMSZ4711T3G  |
| SMMSZ4711T1G   | SZBZX84C30LT1G | SZMMBZ5248BLT1G | SZMMSZ4714T1G  |
| SMMSZ4713T1G   | SZBZX84C33ET1G | SZMMBZ5248BLT3G | SZMMSZ5242ET1G |
| SMMSZ5252BT1G  | SZBZX84C33ET3G | SZMMBZ5249BLT1G | SZMMSZ5243BT1G |
| SMMSZ5252ET1G  | SZBZX84C36LT1G | SZMMBZ5250ELT1G | SZMMSZ5244ET1G |
| SMMSZ5254BT1G  | SZBZX84C36LT3G | SZMMBZ5252ELT1G | SZMMSZ5245CT1G |
| SMMSZ5256BT1G  | SZBZX84C39ET1G | SZMMBZ5253BLT1G | SZMMSZ5248BT1G |
| SMMSZ5260BT1G  | SZBZX84C39LT1G | SZMMBZ5254BLT1G | SZMMSZ5248CT1G |
| SZBZX84C11LT1G | SZBZX84C39LT3G | SZMMBZ5256BLT1G | SZMMSZ5249BT1G |
| SZBZX84C11LT3G | SZBZX84C43ET1G | SZMMBZ5257ELT1G | SZMMSZ5250BT1G |
| SZBZX84C13LT1G | SZBZX84C47ET1G | SZMMBZ5259BLT1G | SZMMSZ5250CT1G |
| SZBZX84C13LT3G | SZBZX84C51ET1G | SZMMBZ5261ELT1G | SZMMSZ5250ET1G |
| SZBZX84C18LT1G | SZBZX84C51LT1G | SZMMBZ5262BLT1G | SZMMSZ5252CT1G |
| SZBZX84C18LT3G | SZBZX84C56ET1G | SZMMBZ5263ELT1G | SZMMSZ5254ET1G |
|                | SZBZX84C56LT1G | SZMMBZ5264BLT1G | SZMMSZ5256CT1G |

**NOTE:**

Please be informed that there are Customer Specific parts impacted by this notice, thus MPN & CPN info will not be reflected in the parts list of this Generic document. Instead please click the link to the addendum copy provided in the email notification to see full list of affected products specific to your company.

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

**Note:** *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22316Z1

発行日 : 16 September 2018

|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 変更件名:                                                                                                               | 更新通知 - IPCN22316Z の取り消し - オン・セミコンダクター ツェナー製品のウエハ製造のオン新潟への移転。AlSiCu トップメタル、Cu ワイヤ、およびヘンケル成形化合物への変更。                    |                         |
| 変更後の材料の初回出荷予定日:                                                                                                     | 該当なし                                                                                                                  |                         |
| 現在の材料の最終注文日:                                                                                                        | 該当なし                                                                                                                  |                         |
| 現在の材料の最終出荷日:                                                                                                        | 該当なし                                                                                                                  |                         |
| 製品カテゴリ:                                                                                                             | アクティブなコンポーネント - 個別コンポーネント                                                                                             |                         |
| 連絡先情報:                                                                                                              | 現地のオン・セミコンダクター営業所または<Hiroshi.Koizumi@onsemi.com>にお問い合わせください。                                                          |                         |
| サンプル:                                                                                                               | 現地のオン・セミコンダクター営業所に注文するか、または<PCN.samples@onsemi.com>にお問い合わせください。<br>サンプルは、この変更通知の発行から 45 日以内に要求してください。                 |                         |
| 追加の信頼性データ:                                                                                                          | お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または<Nicky.Siu@onsemi.com>にお問い合わせください。                                                           |                         |
| 通知種別:                                                                                                               | オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせが行われない限り、この変更の取り消しが承諾されたものとみなします。前記については、<PCN.Support@onsemi.com>にお問い合わせください。 |                         |
| カテゴリ変更                                                                                                              | 変更種別                                                                                                                  |                         |
| プロセス - ウエハ生産                                                                                                        | 新規メタライゼーション / メタライゼーションの変更 (特にチップ前面)"<br>ウエハ工場のすべてまたは一部の異なる場所 / 拠点 / 半導体サブコンへの移動 (追加製造拠点の認定)                          |                         |
| プロセス - 組み立て                                                                                                         | ワイヤ ボンディングの変更<br>成形化合物の変更                                                                                             |                         |
| 説明および目的:<br><br>IPCN22316Z の取り消しに関する更新通知 - オン・セミコンダクター ツェナー製品のウエハ製造のオン新潟への移転。AlSiCu トップメタル、Cu ワイヤ、およびヘンケル成形化合物への変更。 |                                                                                                                       |                         |
| 変更の理由 / 動機:                                                                                                         | 該当なし                                                                                                                  |                         |
| 適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関して見込まれる影響:                                                                            | 該当なし                                                                                                                  |                         |
| 影響を受ける拠点:                                                                                                           | オン・セミコンダクター拠点:<br>オン ISMF (マレーシア)<br>オン梁山 (中国)<br>オン新潟 (日本)                                                           | 外部製造工場 / 下請け業者拠点:<br>なし |
| 部品の表示 / 変更の追跡可能性:                                                                                                   | 該当なし                                                                                                                  |                         |
| 信頼性データの要約: 該当なし                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |
| 電気特性の要約: 該当なし                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号 : IPCN22316Z1

発行日 : 16 September 2018

## 影響を受ける部品の一覧:

|                |                |                 |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| SMMSZ4698T1G   | SZBZX84C24ET1G | SZBZX84C62ET1G  | SZMMSZ4698T1G  |
| SMMSZ4701T1G   | SZBZX84C27LT1G | SZBZX84C75ET1G  | SZMMSZ4701ET1G |
| SMMSZ4704T1G   | SZBZX84C27LT3G | SZMMBZ5241BLT1G | SZMMSZ4711T3G  |
| SMMSZ4711T1G   | SZBZX84C30LT1G | SZMMBZ5248BLT1G | SZMMSZ4714T1G  |
| SMMSZ4713T1G   | SZBZX84C33ET1G | SZMMBZ5248BLT3G | SZMMSZ5242ET1G |
| SMMSZ5252BT1G  | SZBZX84C33ET3G | SZMMBZ5249BLT1G | SZMMSZ5243BT1G |
| SMMSZ5252ET1G  | SZBZX84C36LT1G | SZMMBZ5250ELT1G | SZMMSZ5244ET1G |
| SMMSZ5254BT1G  | SZBZX84C36LT3G | SZMMBZ5252ELT1G | SZMMSZ5245CT1G |
| SMMSZ5256BT1G  | SZBZX84C39ET1G | SZMMBZ5253BLT1G | SZMMSZ5248BT1G |
| SMMSZ5260BT1G  | SZBZX84C39LT1G | SZMMBZ5254BLT1G | SZMMSZ5248CT1G |
| SZBZX84C11LT1G | SZBZX84C39LT3G | SZMMBZ5256BLT1G | SZMMSZ5249BT1G |
| SZBZX84C11LT3G | SZBZX84C43ET1G | SZMMBZ5257ELT1G | SZMMSZ5250BT1G |
| SZBZX84C13LT1G | SZBZX84C47ET1G | SZMMBZ5259BLT1G | SZMMSZ5250CT1G |
| SZBZX84C13LT3G | SZBZX84C51ET1G | SZMMBZ5261ELT1G | SZMMSZ5250ET1G |
| SZBZX84C18LT1G | SZBZX84C51LT1G | SZMMBZ5262BLT1G | SZMMSZ5252CT1G |
| SZBZX84C18LT3G | SZBZX84C56ET1G | SZMMBZ5263ELT1G | SZMMSZ5254ET1G |
|                | SZBZX84C56LT1G | SZMMBZ5264BLT1G | SZMMSZ5256CT1G |

## 注:

本通知により影響を受ける顧客特定部品があるため、MPN および CPN 情報は本一般文書の部品リストに反映していないことにご留意ください。  
代わりに、特に御社に影響する製品の全リストを閲覧するには、電子メール通知で提供される補遺コピーへのリンクをクリックしてください。